

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2019年4月25日(25.04.2019)



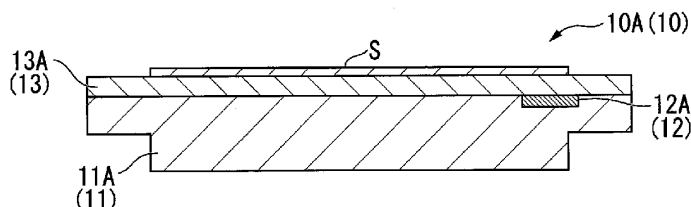
(10) 国際公開番号

WO 2019/078149 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/3065 (2006.01) H05H 1/46 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2018/038294
- (22) 国際出願日: 2018年10月15日(15.10.2018)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2017-201074 2017年10月17日(17.10.2017) JP
- (71) 出願人: 株式会社アルバック (ULVAC, INC.)
[JP/JP]; 〒2538543 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2 5 0 0 Kanagawa (JP).
- (72) 発明者: 加賀美 剛 (KAGAMI Tsuyoshi);
〒2538543 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2 5 0 0
株式会社アルバック内 Kanagawa (JP). 福
本 英範(FUKUMOTO Hidenori); 〒2538543 神
奈川県茅ヶ崎市萩園 2 5 0 0 株式会
社アルバック内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 及川 周, 外 (OIKAWA Shu et al.);
〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁
目9番2号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,

(54) Title: APPARATUS FOR TREATING OBJECT TO BE TREATED

(54) 発明の名称: 被処理体の処理装置



(57) Abstract: An apparatus for treating an object to be treated according to the present invention comprises: a chamber having an internal space, the pressure of which can be reduced, the chamber being configured such that a plasma treatment is performed on an object to be treated in the internal space; a first electrode which is disposed in the chamber and on which the object to be treated is mounted; a first power source which applies negative potential bias voltage to the first electrode; a gas-introducing device which introduces process gas into the chamber; and an exhausting device which reduces the pressure in the chamber. A cover portion is provided between the first electrode and the object to be treated so as to cover the first electrode. A spacer portion is disposed between the first electrode and the cover portion so as to occupy a local region.

(57) 要約: 本発明の被処理体の処理装置は、内部空間が減圧可能で、前記内部空間において被処理体に対してプラズマ処理されるように構成されたチャンバと、前記チャンバ内に配され、前記被処理体を載置するための第一電極と、前記第一電極に対して、負電位のバイアス電圧を印加する第一電源と、前記チャンバ内にプロセスガスを導入するガス導入装置と、前記チャンバ内を減圧する排気装置と、を備える。前記第一電極と前記被処理体との間に、前記第一電極を覆うように設けられたカバー部が設けられている。前記第一電極と前記カバー部との間にあって、局所的な領域を占めるように、スペーサ部が配置されている。

[続葉有]

WO 2019/078149 A1

TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

— 国際調査報告（条約第21条(3)）